

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	中金资管、敦和资管、财通资管、蜂巢基金、景顺长城、涌乐投资、东吴证券、鑫元基金、运舟资本、复胜投资、长信基金、长盛基金、保银基金
时间	2025年5月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2025Q1 稼动率水平及全年预期？</p> <p>2025年Q1存在春节假期影响和季节性波动，但公司下游需求旺盛，营收同比增长约30%。Q2稼动率持续上升，成熟产品线稼动率饱满，下游需求强劲。</p> <p>2、晶圆级封测进展？</p> <p>公司晶圆级封测的稼动率不断提高，毛利率环比逐季度改善；展望下半年，随着大客户相关产品的导入，稼动率水平有望提升，促进毛利率转正。</p> <p>3、2.5D 先进封装量产时间表？</p> <p>公司2.5D封装已于2024年四季度完成通线，目前正积极与客户进行产品验证。</p> <p>4、IoT 领域 70%的营收占比是否可持续？驱动力是什么？</p> <p>公司核心IoT领域客户竞争力持续增强，市场份额逐步</p>

	<p>提升，公司伴随客户一同成长；此外，IoT 领域目前处于“创新驱动”周期，AI 驱动下新应用场景渗透率提升，下游需求稳健增长。</p> <p>5、车载 CIS 技术路线及扩产计划？</p> <p>公司 CIS 采用 BGA 的封装路线，相较于其他方案可靠性更高。</p> <p>CIS 产品线目前满产，后续将根据客户需求审慎稳健的控制扩产节奏。</p> <p>6、2025 年资本开支规划？</p> <p>公司已审议的 2025 年资本开支规模在 25 亿元以内，较 2024 年保持稳定，主要投向包括现有产品线产能扩张、晶圆级封装及 2.5D、FC-BGA 等先进封装领域。</p> <p>7、2025 年折旧预期？折旧压力缓解时间点？</p> <p>公司预计今年折旧金额同比小幅增长。根据公司设备的折旧年限以及营收规模，随着原有投资设备折旧期陆续到期，预计后续折旧压力将有所缓解，拐点取决于新增投资力度和原有折旧到期之间的平衡，预计未来两三年有望拐点。</p> <p>8、毛利率改善措施？</p> <p>公司将持续成长，通过规模效应逐步减少折旧所产生的影响；另一方面，公司积极优化产品结构，努力提高晶圆级产品的稼动率并优先承接毛利率较高的产品，以促进毛利率水平正向发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 30 日